

表 各装置の標準講習時間(1)

	装置No.	装置名	メーカー / 型番	装置講習時間 [h]	利用者サンプル	備考
安全教育	-	安全教育 (吉田キャンパス)	場所：物理系校舎328室 サテライトオフィス	1		・初回の装置講習前に実施。
	-	安全教育 (桂キャンパス)	場所：桂C3棟 cB1N03 機械系C R管理室	1		・初回の装置講習前に実施。
A. ナノリングラフイー装置群	A01	高速高精度電子ビーム描画装置	エリオニクス / ELS-F125HS	4		・アライメント：+2時間
	A02	露光装置 (ステッパー)	ニコン / NSR-2205i11D	2	○ (アライメント)	・アライメント：+1時間
	A03	レーザー直接描画装置	Heidelberg Instruments / DWL2000	2		・アライメント：+1時間
	A04	高速マスクレス露光装置	ナノシステムソリューションズ / D-light DL-1000GS/KCH	2		・アライメント：+1時間
	A05	両面マスクアライナー	ズース・マイクロテック / MA6 BSA SPEC-KU/3	2		・(両面)アライメント含む
	A06	紫外線露光装置	ミカサ / MA-10	1		
	A07	厚膜フォトレジスト用スピニング装置	ズース・マイクロテック / DELTA80 T3/VP SPEC-KU	0.5		・ペーパープライマー(HMDS) ・コーター：+2時間
	A08	レジスト塗布装置	カナメックス / KRC-150CBU	1		
	A09	スプレーコータ	ウシオ電機 / USC-2000ST	2		
	A10	レジスト現像装置	カナメックス / KD-150CBU	1		
	A11	ウエハスピン洗浄装置	カナメックス / KSC-150BU	1		
	A12	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー / Agilent 7700s	3	○	
	A13	超微細インクジェット描画装置	SDIテクノロジー / F700S	1.5		
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	カナメックス / KD(EB)-150CBU	1		
	A15	大面積超高速電子ビーム描画装置	アドバンテスト / F7000S-KYT01	4		・データ変換含む ・アライメント：+3時間
A52	ステッパ	大日本科研 / KS-7000	3			
A53	移動マスク紫外線露光装置	大日本科研 / MUM-0001	1			
A54	両面マスクアライナー露光装置	ユニオン光学 / PEM-800	1			
B. ナノ材料加工・創製装置群	B01	多元スパッタ装置 (仕様 A)	キヤノンアネルバ / EB-1100	2		
	B02	多元スパッタ装置 (仕様 B)	キヤノンアネルバ / EB-1100	2		
	B03	電子線蒸着装置	キヤノンアネルバ / EB-1200	3	○	
	B04-1	真空蒸着装置	サンバック / RD-1400	2	○	
	B04-2	真空蒸着装置	サンバック / RD-1400	2		
	B05	プラズマCVD装置	住友精密工業 / MPX-CVD	4	○	
	B06	集束イオンビーム走査電子顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー / Nvision40PI	3		
	B07	熱酸化炉	光洋サーモシステム / MT-8X28-A	1	○	
	B08-1	深堀りドライエッチング装置 (Φ6")	サムコ / RIE-800iPB-KU	2	○	
	B08-2	深堀りドライエッチング装置 (Φ4")	サムコ / RIE-800iPB-KU	2	○	
	B09	磁気中性線放電ドライエッチング装置	アルバック / NLD-570	2		・塩素系ガス：+1時間
	B10	ドライエッチング装置	サムコ / RIE-10NR-KF	1		
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	エリオニクス / EIS-1200	3		
	B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業 / MLT-SLE-Ox	5	○	
	B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	XACTIX / Xetch X3B	2	○	
	B14	赤外フェムト秒レーザー加工装置	AVESTA PROJECT / CrF-65	3	○	
	B15	レーザアニール装置	AOV / LAEX-1000	2	○	
	B16	紫外線ナノインプリントボンダアライメント装置	ズース・マイクロテック / MAB/BA8 Gen3 SPEC-KU	2	○	
	B17	基板接合装置	ズース・マイクロテック / SB8e SPEC-KU	2	○	
	B18	レーザダイシング装置	東京精密工業 / Mahoh Dicer ML200	3		
	B19	ダイシングソー	ディスコ / DA D322	2		
	B20	真空マウンター	日本電気 / VTL-201	0.5		
	B21	紫外線照射装置	テクノビジョン / LED-4082	0.5		
	B22	エキシバンド装置	テクノビジョン / TEX-21BG GR-5	0.5		
	B23	ウェッジワイヤボンダ	WEST BOND / 7476D	1		
	B24	ボールワイヤボンダ	WEST BOND / 7700D	1		
B25	ダイボンダ	WEST BOND / 720CE	0.5			
B26	ナノインプリントシステム	Obducat / Eitre 3	1			
B27	赤外透過評価検査・非接触厚み測定機	モリテックス / IRise-T	1			
B51	パリレン成膜装置	SCS / LABCOTER PDS-2010	3			
B52	ICP-RIE装置	ULVAC / NE-730	2	○		
B53	簡易RIE装置	サムコ / FA-1	1			
B54	ウエハ接合装置	ボンドテック / WAP-100	3			
B55	ナノインプリント装置	マルニ / TP-32937	1			
B56	ダイシング装置	ディスコ / DAD322	1			

表 各装置の標準講習時間(2)

装置No.	装置名	メーカー / 型番	装置講習時間 [h]	利用者サンプル	備考
C01	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ / SU-8000	2		
C02	分析走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ / SU-6600	2		・LPSEM : +2時間 ・EDS : +2時間 ・EBSD : +2時間
C03	高速液中原子間力顕微鏡	生体分子計測研究所 / NLV-KS	3		
C04	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインスツルメンツAG / NanoWizard III NW3-XS-0	2		
C05	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス / FV1000	1		
C06	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス / OLS4000-SAT	1		
C08	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス / TIRFM	2		
C09	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス / IX81-ZDC2	2		
C10	X線回折装置	リカク / SmartLab-9K	1	○	
C11	分光エリブソメーター	大塚電子 / FE-5000	1		・Cauchyモデル
C12	光ピンセットシステム	JPKインスツルメンツAG / NanoTracker NT-0-001	1.5		
C13	ゼータ電位・粒径測定システム	大塚電子 / ELSZ-2Plus	3		
C14	ダイナミック光散乱光度計	大塚電子 / DLS-8000DH	3		
C15-1	触針式段差計(CR)	BRUKER / Dektak150	1		
C15-2	触針式段差計(加工評価室)	BRUKER / Dektak150	1		
C16	マイクロシステムアナライザ	ポリテック / MSA-500-TPM2-20-D-KU	3		・面外振動のみ ・面内振動 : +1時間 ・形状計測 : +1時間
C17	(ブローバ)	日本マイクロニクス / 708FT	0.5	○	
C18	(真空ブローバ)	カスケードマイクロテック / PLV50	1	○	
C19	パワーデバイスアナライザ	アジレントテクノロジー / B1505A	1.5	○	・併用 : C17
C20	インピーダンスアナライザ	アジレントテクノロジー / 4294A	1	○	・併用 : C18 or C26
C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク / MLD-230D-200K	1		
C22	超微小材料機械変形評価装置	エリオニクス / ENT-2100	2		
C24	セルテストシステム	ソーラトロン / 1470E-Type/1260型	1	○	
C25	卓上顕微鏡 (SEM)	日立ハイテクノロジーズ / TM3000	1		
C26	高周波伝送特性測定装置	アボロウエーブ / a150	0.5	○	
C27	(RFプローブキット)	アボロウエーブ / ZPROEE	0.5	○	・併用 : C27, C28
C28	(ネットワークアナライザ)	ROHDE & SCHWARZ / R&S ZVB	2	○	・併用 : C26, C27
C29	(半導体パラメータアナライザ)	ケースレーインスツルメント / 4200-SCS	1	○	・併用 : C18 or C26

C: ナノ材料分析・評価装置群

注. (1) 上記の装置講習時間は標準的な所要時間を示しております。サンプルの数量・加工条件等によっては長時間を要する場合があります。

(2) 安全教育は各キャンパス毎に事前(装置講習前)に受講して頂く必要があります。

通常は初回の装置講習前に実施しておりますので、装置講習のスケジュール調整の際にはご注意ください。